

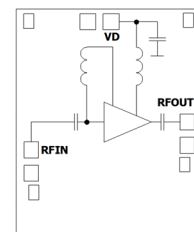
关键指标

- 频率范围: 0.9~3GHz
- 增益: 33dB
- 噪声系数: 0.4dB Typ. 0.6dB Max
- 输出 P_{1dB} : 16dBm@+5V
- 供电: +5V/55mA
- 封装尺寸: 3mmx3mmx1.1mm
- 裸芯片尺寸: 1.25mmx1.5mmx0.1mm

产品简介

HX140010F3是一款低噪声放大器，该放大器采用 GaAs 工艺制成，封装形式为 QFN 结构，裸芯片表面有钝化层保护，可工作于 0.9~3GHz 频段，当使用+5V 供电时该放大器的小信号增益为 33dB，输出 P_{1dB} 为 16dBm，工作电流为55mA 左右，噪声系数典型值为 0.4dB。

功能框图



电性能 ($T_A=25^\circ\text{C}$, $V_D=+5\text{V}$, $I_D=55\text{mA}$, $Z_0=50\Omega$)

指标	最小值	典型值	最大值	单位
频率	0.9~3			GHz
增益	30	33	—	dB
增益平坦度	—	± 1	—	dB
输入/输出驻波比	—	1.5	2.0	:1
噪声系数	—	0.3	0.6	dB
反向隔离度	—	-45	—	dB
输出 P_{1dB}	14	16	—	dBm
输出 IP_3	—	30	—	dBm
工作电流(I_D)	—	55	75	mA

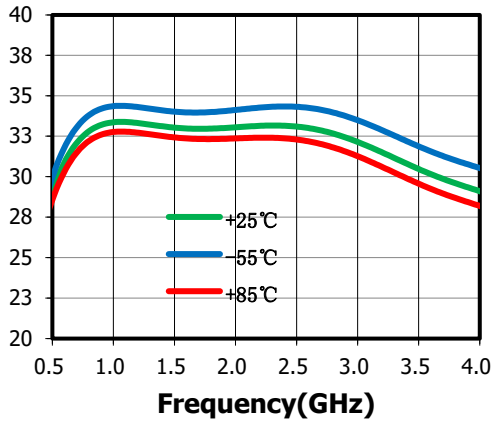
绝对最大额定值

最大输入功率	+17dBm,CW 30s	工作温度	-55°C~+85°C
沟道温度	+150°C	贮存温度	-55°C~+150°C
工作电压	+7V		

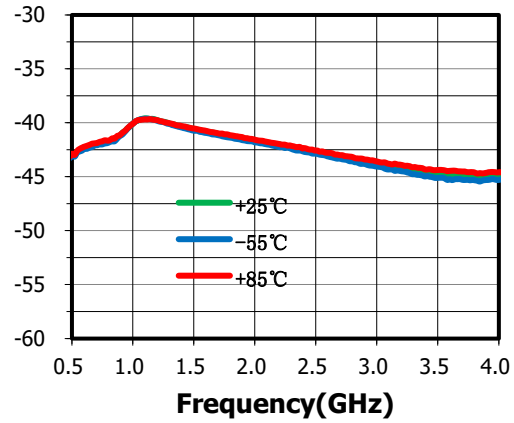
典型性能曲线

$V_D=+5V$ $I_{DQ}=55mA$, 以下曲线为使用 HX140010F3评估板测得

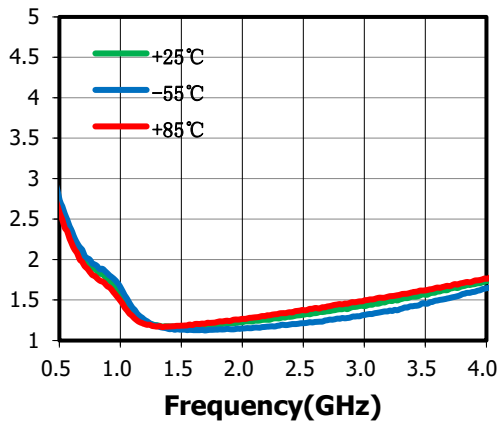
Small Signal Gain(dB) vs.Temperature



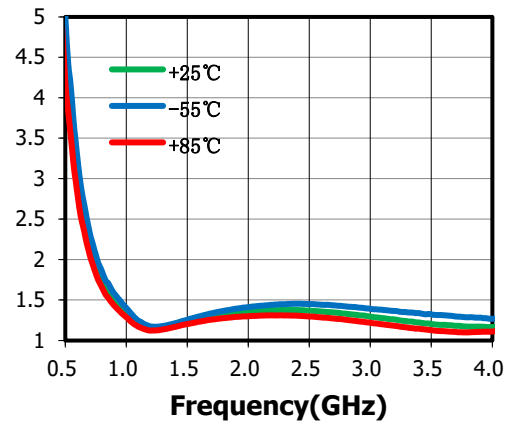
Reverse Isolation(dB) vs.Temperature



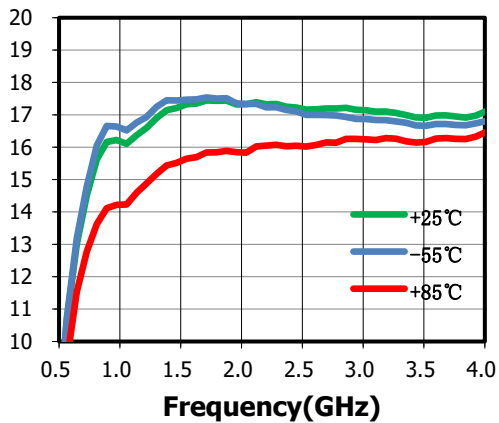
Input VSWR(:1) vs.Temperature



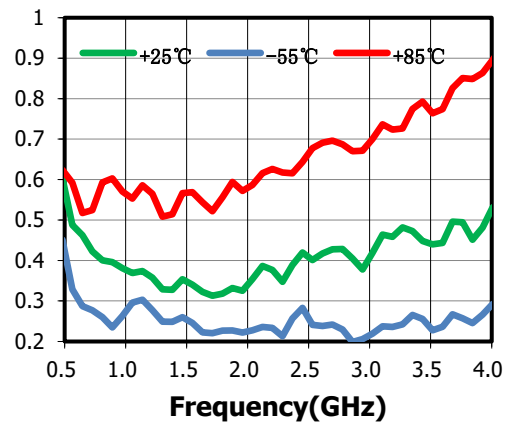
Output VSWR(:1) vs.Temperature

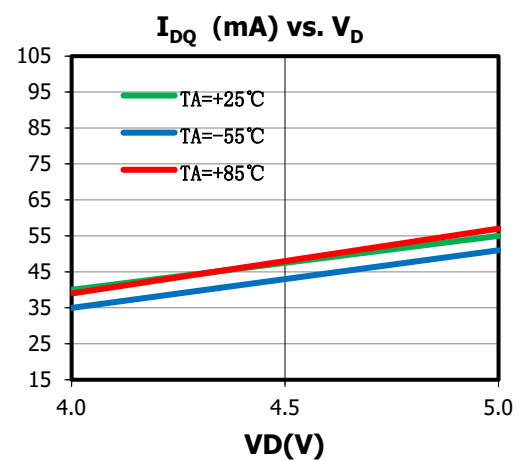
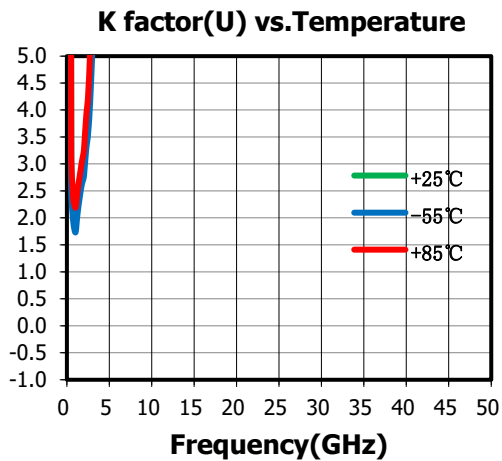
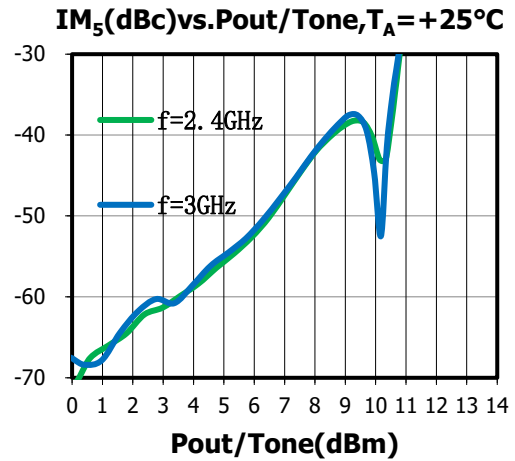
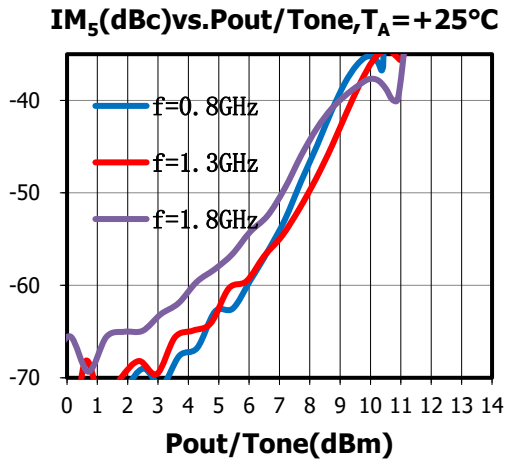
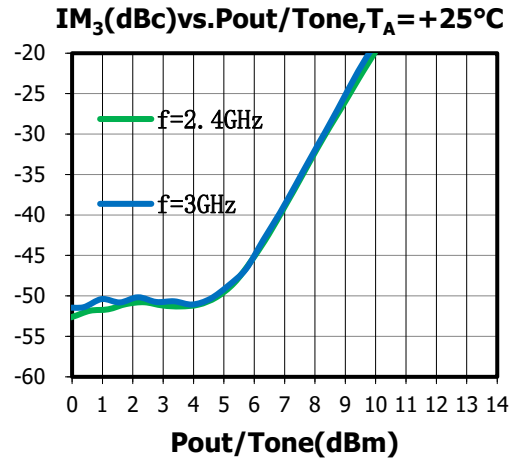
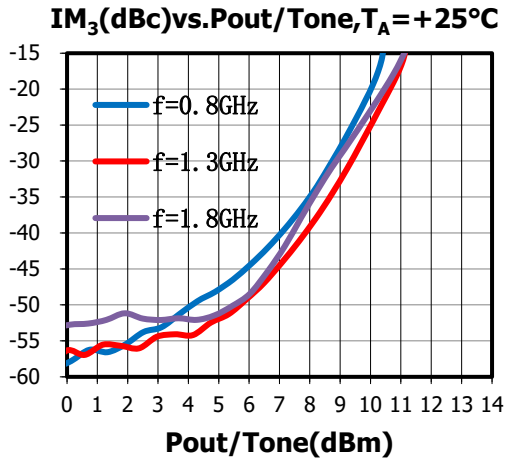


Output P-1dB(dBm) vs.Temperature

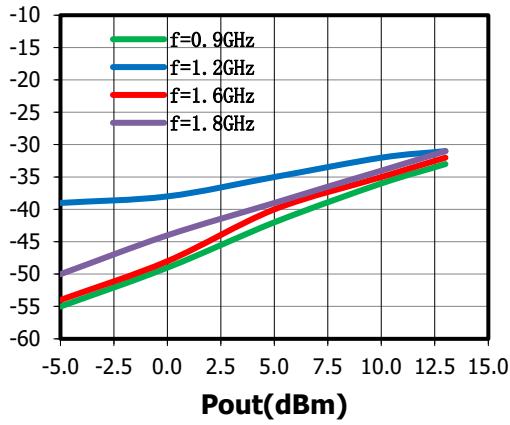


Noise Figure(dB) vs.Temperature

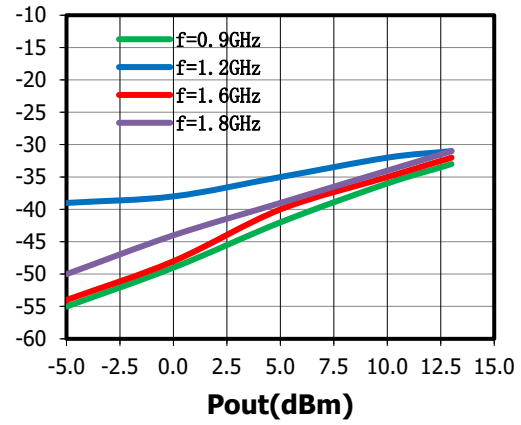




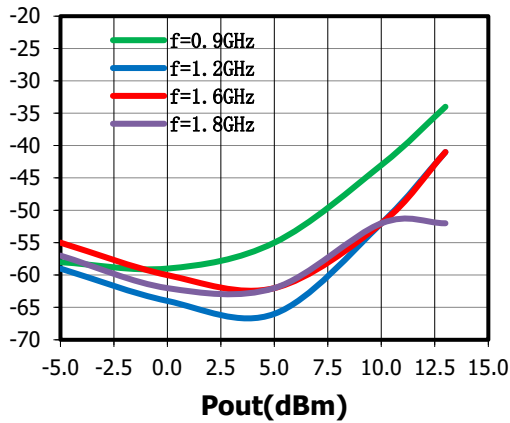
2ND Harmonic vs. Pout, T_A = +25°C



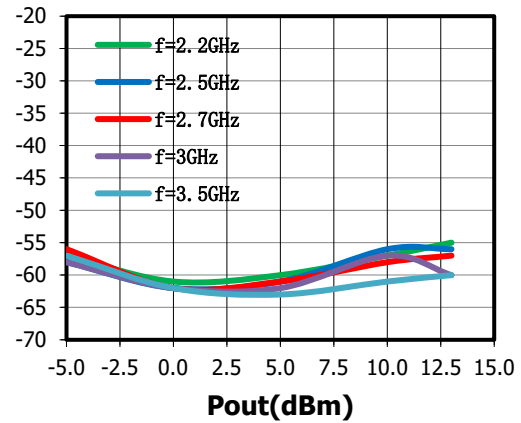
2ND Harmonic vs. Pout, T_A = +25°C



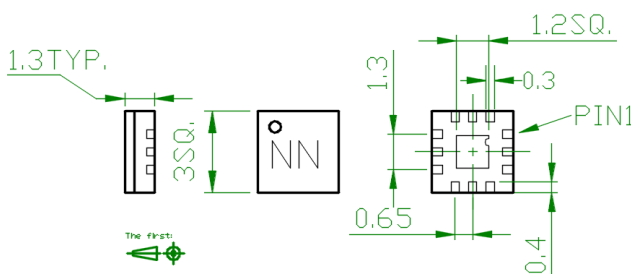
3RD Harmonic vs. Pout, T_A = +25°C



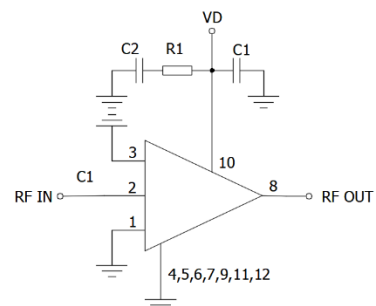
3RD Harmonic vs. Pout, T_A = +25°C



封装外形尺寸 (mm)



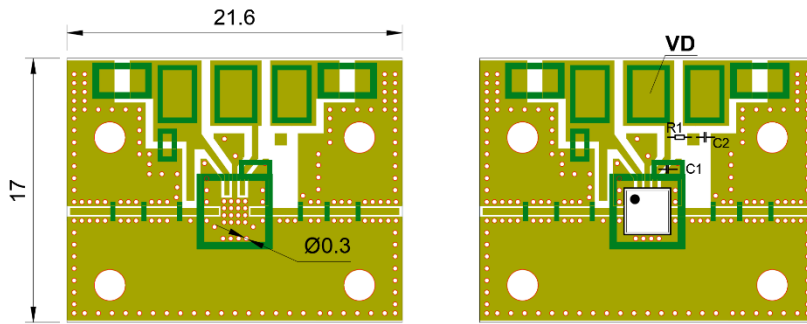
应用电路图



引脚功能

编号	说明	编号	说明
1	接地	7	接地
2	射频输入, 交流耦合	8	射频输出, 交流耦合
3	接地	9	接地
4	接地	10	漏极供电
5	接地	11	悬空或接地
6	接地	12	悬空或接地

HX140010F3评估板

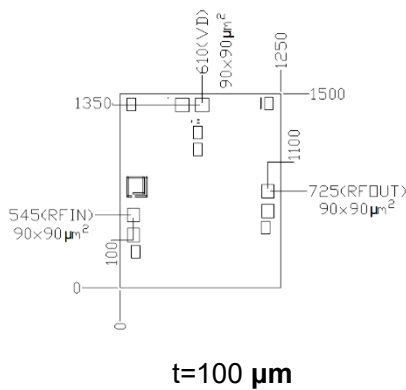


评估板板材为 Ro4350b, 介质厚度 0.254mm, 输入与输出传输线设计阻抗为 50Ω

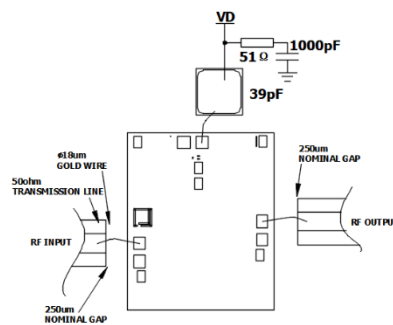
元件清单

编号	数值	封装	说明
C1	56pF	0402	该电容排版时尽可能靠近 PIN10
C2	0.1μF	0402	
R1	10Ω	0402	

裸芯片外形尺寸(μm)



裸芯片推荐装配图



注意事项:

1. 裸芯片必需在干燥、氮气环境中存储，在超净环境中使用；
2. GaAs 材料较脆，不能触碰芯片表面，使用时必须小心；
3. 芯片用导电胶或合金烧结（合金温度不能超过 300°C，时间不能超过 30 秒），使之充分接地；
4. 芯片微波端口与基片间隙不超过 0.45mm，使用 $\Phi 18 \mu\text{m}$ 金丝键合，建议金丝长度 350~450 μm ；
5. 芯片对静电敏感，在储存和使用过程中 注意防静电；
6. 芯片射频输入和输出端口已集成隔直电容，耐压 20V；
7. 封装后的产品防潮等级为 2a 级，存放环境小于或等于 30° C/60% RH，四周车间寿命；
8. 使用封装产品时尽可能使用薄的射频板材并且在器件底部增加接地过孔数量以便降低接地电感量；
9. 撤除真空包装，上回流焊前需在 125+/-5° 环境中烘焙 6 小时，方可焊接。